

## 揭露書填寫須知

專利申請及維護所衍生之各項規費如無其他來源補助（國科會、合作廠商等）時，依據「元智大學研發成果與技術移轉管理施行細則」第五條規定，並經「研發成果評量委員會」決議，本校負擔申請規費 80%，發明人負擔申請規費 20%。

3.聯絡人	<b>第一順位</b> <span style="color: red;">（校內專任教師或職技同仁）</span>	聯絡電話	
	<b>第二順位</b>	聯絡電話	
各項權益分配及相關通知，本校僅通知上述相關聯絡人，聯絡人應負義務協助轉悉。			

4.申請案產出來源	申請人務必確認產出來源，以保障本校權益。 <input type="checkbox"/> 計畫產出（請於第 5 項述明 <sup>①②</sup> ） <input type="checkbox"/> 自行研發 <input type="checkbox"/> 其他_____		
5.申請案所屬計畫及專利權歸屬	專利權歸屬 <sup>③</sup>	<input type="checkbox"/> 元智大學_____% <input type="checkbox"/> 計畫出資單位_____% <input type="checkbox"/> 其他_____%	
	歸屬單位 <sup>④</sup>	<input type="checkbox"/> 申請人所屬系所 <input type="checkbox"/> 研究中心_____ <input type="checkbox"/> 其他_____	
	計畫名稱		
	計畫編號	計畫主持人	
	資助單位	計畫金額	
	規費出資比 <sup>⑤</sup>	申請費(含服務費)	_____ %
		核駁費(含服務費)	_____ %
		領証費(含服務費)	_____ %
		維護費(含服務費)	_____ %
除國科會產學計畫外，國科會其他補助計畫研發成果歸屬全數本校者免填			
<sup>①</sup> ：若為多項計畫共同產出，以最主要計畫來源作為認定標準，並請附合約書影本；如為國科會計畫產出，請附計畫核定清單乙份。 <sup>②</sup> ：未經本校同意，不得將本申請案列入非所屬計畫之產出。 <sup>③</sup> ：專利權歸屬：國科會計畫請參閱計畫核定清單「研發成果歸屬」；餘計畫請依雙方簽訂合約相關條文填寫。 <sup>④</sup> ：成果歸屬若為校內中心/校內專案計畫，需經所屬單位主管確認，始得提出申請。 <sup>⑤</sup> ：申請時請明列規費（申請費、核駁費、領証費及維護費）中心或計畫出資單位負擔比例。			

此指校內研究  
績效歸屬單位

請參閱國科會核定清單內  
「研究成果歸屬」說明

6.申請國家	（請填寫申請優先順序） <input type="checkbox"/> 中華民國 <input type="checkbox"/> 美國 <input type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 歐盟 <input type="checkbox"/> 其他國家	請以數字表示 其優先順序
--------	--	-----------------

<p>9. 申請國別請由 (請依申請之 優先順序填寫)</p>	<p>① 申請_____國之理由 請就(1)國內企業界實施可能性(2)國內公司授權可能性(3)國內外交互授權 之可能性市場規模與銷售政策間之關聯性等填寫，勿填寫「XX 國家無此 項技術或專利」</p>
---	--

<p>10. 公開揭露紀錄</p>	<p>是否已公開？<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否，未來會公開 如已公開或預計公開，請確實註明公開情況、公開發表時間及場所</p>
-------------------	--

以中華民國為  
例，新穎性為公  
開後起算 6 個月  
內

- ：1. 為維持發明/創新內容之新穎性及機密性，建議如非必要，請勿在專利申請前，公開發表與該申請案相關之核心技術與資料。
- 2. 若已先行公開發表，請特別注意我國專利法第二十二條所示「不喪失新穎性情事」之申請有效日期及申請各國專利新穎性喪失的影響。
- 3. 對於申請前已公開發表之案件，一般可能無法申請歐盟各國專利。申請日本及大陸專利對公開行為，在新穎性上認定較美國嚴苛。

14. 相關技術先前調查

(1) 已檢索之專利資料 (請就相關研發領域中, 檢索目前各主要國家已核准申請之專利資料, 所欲申請國別之專利檢索資料至少十筆以上, 建議以專利技術功效表方式陳述)

檢索專利資料至少 10 筆以上, 未滿 10 筆者, 請提供檢索之 KEYWORD, 或因技術之新穎性檢索資料未滿 10 筆者請另註明之

(2) 相類似技術或學術研究報告 (目前是否有類似技術或發明被公開或發表於刊物、會議、公開之展覽會等, 請註明其已公開發表之出處、時間、場所)

(3) 習知技術 (或現有技術) 內容及缺失簡要說明

請列出本技術在方法/構造/裝置/形狀/成份/組成上與習知技術之比較，具有創新、進步性或功效等獨特技術部份，得以行使排除他人侵權及請求損害之專有權利，建議撰寫模式參照專利法第 26 條之相關規定撰寫，並提供其代表圖式及說明。

**專利法 26 條**

前條之說明書，應載明發明名稱、發明說明、摘要及申請專利範圍。

發明說明應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施。

申請專利範圍應明確記載申請專利之明，各請求項應以簡潔之方式記載，且必須為發明說明及圖式所支持。

發明說明、申請專利範圍及圖式之揭露方式，於本法施行細則定之

**【專利範圍 (Claim) 通常以條列式陳述之】**

20. 欲保護之專利範圍(Claim)

所屬單位主管/計畫出資單位簽名處	申請人簽名處
<p>申請技術之智慧財為多方共享時，需得他方（如計畫出資單位等）之同意始得申請</p> <p>年 月 日</p>	<p>日期：年 月 日</p>